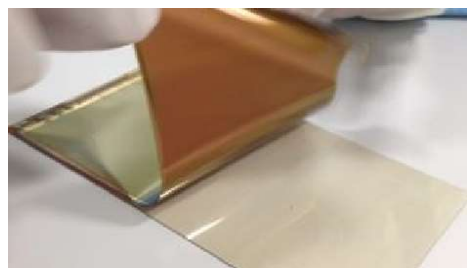


低価格 固体UVレーザーLLO装置 LSL-100F

応用

フレキシブルディスプレイ工程、LED製造、極薄シリコンウエハ工程において形成されたデバイスを基板の裏からレーザーにより剥離するレーザーリフトオフ・プロセス(LLO) が使われるようになってきました。アブレーション加工出来る材質であればガラス基板や有機フィルムなどレーザー光を透過する基板を用いてレーザー照射により瞬間的に界面の剥離が可能のため、用途が急速に広がっています。



フレキシブルディスプレイ



極薄シリコンウエハ

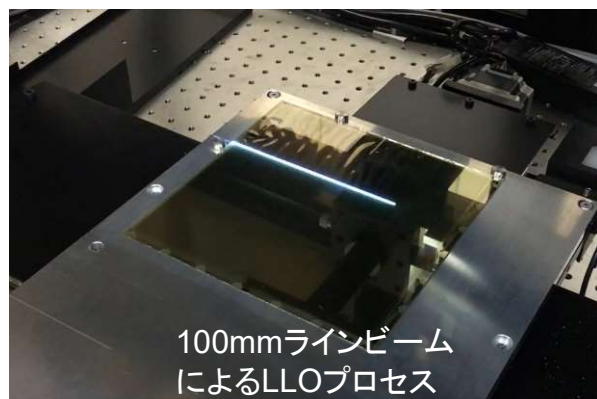


有機半導体

装置の特徴

本装置は固体UVパルスレーザーを用いて弊社独自の光学設計により均一ラインビームを基板に照射し、ワークをステージで動かすことにより基板全面にLLOプロセスを行うための小型低価格装置です。**新型レーザーを採用することにより、LLO品質が格段に向上しました。**

1. 小型・低価格(キャスターにより移動可能)
2. 電源のみで使用可能
3. クラス4の安全対策(光路/摺動部遮蔽・インターロック安全回路)



100mmラインビームによるLLOプロセス

仕様

波長	355nm
ラインビームサイズ	100mm x 0.4mm
照射エネルギー密度	30~300mJ/cm ² 可変 (バリアブルアッテネータ)
ビームオーバーラップ	0%~95% (ステージ制御)
ワークサイズ(mm)	370mm x 470mm (ご要求により600角まで設計)
処理能力	5分 (200mm角パネル)
ステージストローク	400mm x 400mm
装置サイズ (mm)	L1500 x W1400 x H1760
ユーティリティ	AC200V/100V 15A



固体UVレーザー
LLO装置

www.optopia.co.jp